參加費 免費

2026 7/27 (一) 17:00-19:30 16:30開放入場

新竹豐邑喜來登大飯店

行政x產業界聯合

福岡縣北九州市經濟使節團 × 台灣新竹科學園區進駐企業・大學之商業媒合會

為促進日台間半導體產業交流，由北九州市長與北九州工商會議所的會長率領代表福岡縣北九州市域的15家半導體企業組成經濟使節團並訪台

- 會場內備有立食自助餐與自由交流區
- 贈送北九州市名產
- 會場內備有中日口譯人員請放心參加

活動目的

本次活動將旨在與台灣的科學園區管理機構、進駐企業及大學等相關單位，透過研討會及交流活動進行資訊交換，並促進日台企業之間的商務往來，及建立長期合作關係。

歡迎有意拓展與日本企業商務合作，或希望於未來進一步評估合作可能性的企業踴躍參與，藉此拓展與日本企業的交流機會，並開創嶄新的合作契機。

北九州市的特徵

位於九州門戶的北九州市，為九州第二大城市，擁有高度技術實力、完善的研究基礎及優秀人才，並具備優良的投資與商業環境。以半導體用戶與供應鏈企業的群聚為核心，已發展出完整的半導體產業生態系。

北九州學術研究都市位於北九州市，匯聚多所大學與企業，並已與台灣新竹、中部及南部各科學園區簽署「促進科學技術等交流合作協定」，雙方持續推動學術與文化交流已逾二十年。



活動時間表

時間	內容(預定)	
16:30-17:00	開放入場	
17:00-18:00	上半場：研討會	介紹北九州市及其投資環境 ●北九州市長 武内 和久 介紹北九州市經濟使節團 ●北九州商工會議所 會頭 津田 純嗣 介紹新竹科學園區及其投資環境 ●新竹科學園區管理局 副局長 游靜秋
18:10-19:30	下半場：商務交流	開會致詞暨祝酒致詞 ●台灣科學園區科學工業同業公會 秘書長 王永壯 閉會致詞 ●北九州產業學術推進機構 理事長 松永 守央 ※會場內備有立食自助餐

活動概要

時　　間：2026年7月27日 (一) 17：00-19：30 (16:30 開放入場)

參加費用：免費

參加人數：最多40位 (每間公司／團體最多報名2位)

※若報名人數超過活動名額，主辦單位將視情況協調並調整參加人員。

報名對象：限進駐台灣科學園區(新竹、中部、南部)的企業、大學與相關機構人士。

會　　場：新竹豐邑喜來登大飯店 新竹縣竹北市光明六路東一段265號

●上半場 研討會 3階東館宴會廳-II

●下半場 商務交流 3階東館宴會廳-III

報名期限：2026年7月3日 (五)

報名方法：請掃描QR CODE線上報名

【立即報名】
請掃描下方 QR Code

參加企業一覽請見背面！

主辦 北九州市 CITY OF KITAKYUSHU　公益財団法人 北九州産業学術推進機構　協辦 北九州商工会議所

洽詢窗口 福岡銀行台北駐在員事務所 TEL:02-2523-8887 MAIL:taipei_staff@gl.fukuokabank.co.jp

北九州市經濟使節團與參加企業介紹

※企業名單依日文企業名稱五十音順排列

半導體與電子零組件
表面處理技術

Aska corporation 株式會社

以功率半導體電極為核心的電鍍委託加工製造商。

半導體領域
回收、再利用

AMITA CIRCULAR 株式會社

將半導體研磨液等廢棄物再資源化，轉化為循環材料的資源循環領域領導企業。

半導體領域
設計・IC設計、
晶圓測試與解析、最終測試與解析

NSW株式會社

從 SoC／FPGA 設計到驗證、嵌入式軟體開發，廣泛承接相關業務的 IT 解決方案供應商。

設備裝置技術領域
半導體前段製程設備與治具

双日九州株式會社

經營半導體相關材料、化學品及精密資材等多元產品的綜合商社。

設備裝置技術領域
半導體前段、後段製程設備與治具

株式會社高田工業所

開發單片式濕式處理設備等產品，並提供維護服務的工程技術企業。

半導體領域
最終測試與解析

東芝Nanoanalysis 株式會社

提供最先進半導體故障解析、結構／表面分析及可靠度評估服務的專業分析委託企業。

設備裝置技術領域
半導體前段、後段製程設備與治具

TOTO株式會社

在靜電吸盤等半導體用陶瓷精密零組件領域中，具備世界頂尖競爭力的製造商。

設備裝置技術領域
物流與倉庫

日本通運株式會社

從製造設備運輸到廠內物流與倉儲，提供半導體供應鏈一條龍支援的物流企業。

設備裝置技術領域
半導體後段製程設備、治具

日本精工株式會社

以高速、高精度搬送技術及客製化自動化設備為強項，主要為大型半導體後段製程製造商提供設備解決方案的設備製造商。

系統・電子領域
電路設計・製作・控制單元設計、
控制單元元件製造（後段製程）

株式會社HighQ Power

運用 SiC／GaN 技術，從事超小型、高效率電源研發的芬蘭半導體企業。

半導體領域
前段製程材料、回收與再利用

濱田重工株式會社
Hamada Rectech株式會社

提供矽（Si）／SiC晶圓再生與加工、薄膜成膜及各類分析服務的晶圓解決方案企業。

設備裝置技術領域
半導體後段製程設備與治具

Headspring株式會社

運用 SiC／GaN 技術進行電路設計與控制技術，承接電力轉換器委託開發的研發型企業。

半導體應用領域
機器人、元件製造（前段製程・後段製程）、
製造設備（前段製程・後段製程）

株式會社安川電機

以機器人、伺服系統等機電整合技術推動半導體製造自動化與高精度化的製造商。

設備裝置技術領域
半導體後段製程設備與治具

RIX株式會社

自行開發清洗設備等產品，並同時提供半導體製造設備零組件維修與再生服務的製造商兼商社。

提供半導體製造設備（維護・組裝・評估）
技術人員派遣、製造代工與人才培訓服務

株式會社WORLD INTEC

以最先進半導體設備為基礎，能進行高階人才培育，並在製造領域具備優勢的綜合人力資源服務企業。

洽詢窗口 福岡銀行台北駐在員事務所　TEL：02-2523-8887　MAIL:taipei_staff@gl.fukuokabank.co.jp